

<<高速分组接入技术>>

图书基本信息

书名：<<高速分组接入技术>>

13位ISBN编号：9787111201038

10位ISBN编号：7111201035

出版时间：2007-1

出版时间：机械工业

作者：黄韬 等编著

页数：332

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<高速分组接入技术>>

内容概要

随着宽带数据和多媒体业务的迅猛发展，第三代移动通信原定目标规定的2Mbit / s的传输速率已经远远不能满足需求，加上WiMAX等宽带无线接入技术竞争带来的压力，促使3G本身必然要向更高带宽的方向演进。

而HSDPA技术达到商用水平，良好地解决了移动宽带化的问题，从而受到业界的广泛关注和大力推进。

《高速分组接入技术（HSDPA/HSUPA）》详细而全面地介绍了HSDPA/HSUPA技术。

全书总的来讲分为两部分，第一部分为HSDPA技术，第二部分为SHUPA技术。

主要介绍包括HSDPA/SHUPS的物理层技术，HSDPA/HSUPA的L2/L3层技术，HSDPA对Iub/Iur接口的影响，HSDPA/HSUPA中合资用的关键技术，HSDPA/HSUPA的性能仿真分析，增强型的HSDPA，HSDPA的TDD模式，HSDPA的网络规划等。

《高速分组接入技术（HSDPA/HSUPA）》可作为信息与通信行为广大从业人员的参考资料，同时也可以作为电子、信息、通信等专业本科生与研究生教材或教学参考书。

<<高速分组接入技术>>

书籍目录

丛书序前言第1章 HSDPA/HSUPA技术的背景和现状1.1 移动通信现状1.2 第三代移动通信标准进展状况1.3 HSDPA/HSUPA技术的概述及演进阶段1.4 HSDPA/HSUPA技术性能分析1.5 HSDPA/HSUPA使用的关键技术1.6 HSDPA与COMA2000 1x EV-DO系统的比较1.7 HSDPA和HSDPA商用前景分析第2章 HSDPA物理层结构2.1 新增信道2.2 基本物理层结构2.3 HS-DSCH信道编辑与调制2.4 物理层HARQ功能与速率匹配2.5 相关信令及流程2.6 UE能力第3章 HSDPA L2/L3层技术3.1 HS-DSCH协议结构3.2 HS-DSCH MAC结构3.3 HARQ协议3.4 MAC层数据格式3.5 信令参数3.6 HS-DSCH协议终止点3.7 移动性处理3.8 无线资源管理第4章 HSDPA对Iub/Iur接口第5章 HSDPA关键技术第6章 增强型HSDPA第7章 HSDPA的TDD模式第8章 HSDPA性能的仿真及分析第9章 HSUPA物理层结构第10章 HSDPA L2/L3层技术第11章 HSDPA关键技术第12章 HSDPA性能的仿真及分析第13章 HSDPA网络规划附录 缩略语参考文献

<<高速分组接入技术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>